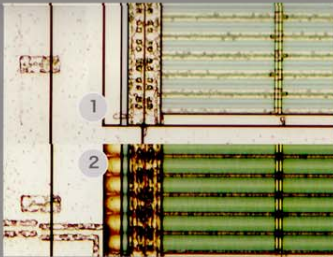


# ガラスまたは半導体上の紫外線成型マイクロ光学素子

- i**
- ・ マイクロレンズ・アレイ、マイクロプリズム、回折素子
  - ・ 任意基板上的高分子薄層
  - ・ 基板に対して正確な縦横配列
  - ・ 耐久性の高い無機・有機高分子ハイブリッド素材
  - ・ その後の加工ステップに対する適合性  
(反射防止膜、ダイス・カット、接着／はんだ付け)

任意基板上に紫外線成型により製造されるセンサー、照明／レーザー・ビーム形成、テレコム等用微小光学チップ



円筒型マイクロレンズ・アレイなし  
(1)円筒型マイクロレンズ・アレイ付き  
(2)CMOSセンサー



選択的紫外線成型により使用できる接着パッド



ガラス上のポリマー、レンズ・アレイ、開口構造、および裏側に金属ピンホールが付いたウエハー・カット後のマイクロ光学チップ

**Fraunhofer**  
Institut  
Angewandte Optik  
und Feinmechanik

Contact: Dr. Andreas Bräuer | andreas.braeuer@iof.fraunhofer.de | +49 36 41 8 07 404

